

MEDEA+-EDA-Konferenz:

Highlights im Bereich der EDA

Im „System on Chip“-Design liegt der Schlüssel für künftige Chipentwicklungen. Unterstrichen wurde dieser Kernaspekt auf der MEDEA+ Design Automation Conference in Stresa durch eine Diskussionsrunde, die den Nutzen der kürzlich veröffentlichten dritten MEDEA+-Roadmap zum Thema EDA erörterte.

Unter der Leitung von Jean-Pierre Noblanc als MEDEA+-Chairman und Gastgeber eröffnete die MEDEA+ Design Automation Conference mit einer Präsentation von Andrea Cuomo, Corporate Vice President und General Manager der Advanced System Technology von STMicroelectronics. Es folgten Andrew B. Kahng, Chairman der Design International Technology Working Group (DITWG), mit der International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) 2001–2002 sowie Joseph P. Borel, der Autor der MEDEA+-Roadmap.

Die Borel-Roadmap (www.medeas.org) zielt auf eine Konsolidierung aller europäischen EDA-Entwicklungen. Sie schließt dabei nicht nur die großen europäischen Anbieter ein, sondern auch die zahlreichen Spezialunternehmen auf diesem Gebiet. Ziel ist es, die Wettbewerbssituation sowohl für die europäische Halbleiterindustrie als auch für die Systemhersteller zu verbessern.

Stand und Zukunft der „Embedded Systems“

Im seinem Einführungsreferat gab Andrea Cuomo einen Überblick über die historische Entwicklung, den heutigen Stand und die Zukunft der „Embedded Systems“. Sein Referat machte die Notwendigkeit für mehr anwendungsorientiertes Design deutlich. Andrew B. Kahng beschrieb die notwendigen Entwicklungen für Entwurf und Entwurfsautomatisierung, wie sie für die ITRS-Roadmap geleistet werden müssen. Nachdrücklich wies er darauf hin, dass die Entwurfsautomatisierung neu gewonnene Erkenntnisse aus der Produktionstechnik aufgreifen und umsetzen muss.

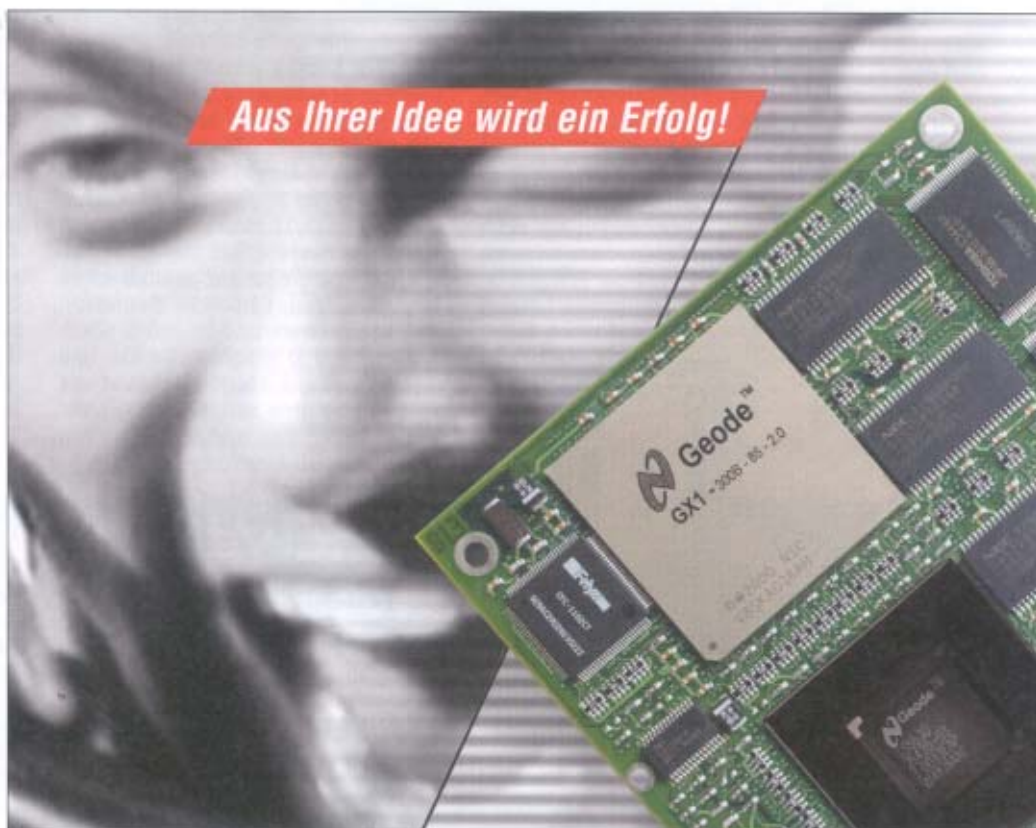
Joseph P. Borel referierte über die jüngsten Entwicklungen in der MEDEA+-Roadmap. Er hob dabei hervor, welche überragende Rolle der „Top down“-Entwurf für künf-

tige Entwicklungen hat. Er betonte ferner, dass die Entwurfsproduktivität für „Embedded Software“ weiter verbessert werden muss. Jean-Pierre Noblanc schließlich fasste die zentrale Rolle der EDA als im MEDEA+-Programm zusammen: Diese sei ein grundlegendes Erfordernis für den Entwurf von „Systems on Chip“.

An der Konferenz nahmen mehr als 100 führende europäische EDA-Spezialisten teil, sowohl aus der Industrie als auch von der Hochschule.

go

Aus Ihrer Idee wird ein Erfolg!



Mit uns schon nach 30 Tagen.

Sie haben richtig gelesen! Sie definieren mit uns Ihre Anforderungen – und schon 30 Tage später halten Sie Ihr maßgeschneidertes **Embedded Industrial Computer Module® (EICM®)** in der Hand! Natürlich mit sämtlichen Feinessen, die alle unsere Komponenten und Systeme auszeichnen, wie einer hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie einem erweiterten Temperaturbereich. Und das alles mit garantierter Langzeitverfügbarkeit und in höchster Qualität – Made in Germany. Nehmen Sie uns beim Wort, damit Sie mit Erfolg „first to market“ sind!

SPS/IPC/DRIVES
Elektrische
Automatisierung
Systeme und Komponenten
Fachmesse & Kongress
26.–28. Nov. 2002 Nürnberg
Halle 2, Stand-Nr. 2-403

ROI Embedded Industrial
Computer Modules®
(EICM®)
COMPUTER AG

www.elektroniknet.de

Justus-von-Liebig-Ring 4+6 • D-82152 Krailing • Tel.: +49 (0)89 89 99 88 00 • Fax: +49 (0)89 89 99 88 99 • e-mail: sales@roi.de • www.roi.de